

## 15 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 15 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.35 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.8 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.



### Elektrische Kenndaten · TA = +25 °C

| Parameter              | Symbol | Minimum | Typisch | Maximum | Wert | Einheit |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|------|---------|
| Anzahl der Widerstände | -      | -       | -       | -       | 1    | -       |
| Anzahl der Anschlüsse  | -      | -       | -       | -       | 2    | -       |
| Widerstand             | -      | -       | 15      | -       | -    | Ω       |
| Widerstandstoleranz    | -      | -       | ±5      | -       | -    | %       |
| Linearer Betriebsstrom | -      | -       | 0.35    | -       | -    | A       |

### Grenzwerte

| Parameter                | Symbol | Minimum | Typisch | Maximum | Einheit |
|--------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Maximal zulässiger Strom | -      | -       | -       | 0.8     | A       |

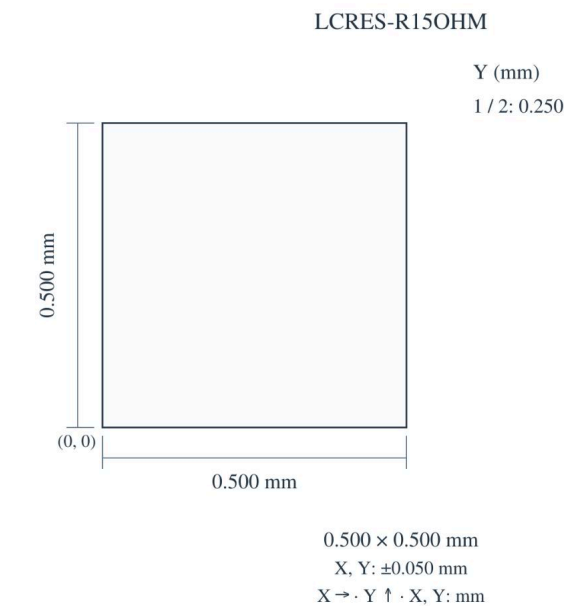
### Umgebungsbedingungen

| Parameter          | Symbol | Minimum | Typisch | Maximum | Einheit |
|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Lagertemperatur    | -      | -65     | -       | 150     | °C      |
| Betriebstemperatur | -      | -55     | -       | 125     | °C      |

Chipabmessungen

| Parameter                         | Wert      | Einheit |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| Chipabmessungen in der Draufsicht | 0.5 × 0.5 | mm      |

Mechanische Maßzeichnung



Alle Maße in mm [in].

Bondpad-Belegung

| Anschlüsse    | Symbol | Funktion                | Hinweise    |
|---------------|--------|-------------------------|-------------|
| 1, 2          | IN/OUT | Reziproker Ein-/Ausgang | -           |
| Chiprückseite | GND    | Masse                   | RF / DC GND |

Aktueller Publikationsstand · 1.1 · 2026-10-23. Die Spezifikationstabellen wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.0.

Chipintegration und Bias-Reihenfolge

Die Chiprückseite muss gut geerdet sein.

Geltungsbereich der mechanischen Referenz

Maßskizze nach Quelldokumentation in mm. Teilinformationen; keine vollständige Fertigungs- oder Bonddrahtzeichnung.

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.